**AMI互通性產業標準建議提案說明**

**(Draft)**

**台灣智慧型電網產業協會**

**2015-01-26**

**文件修改記錄**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **修改日期** | **修改人** | **問題單 流水號** | **修改原因及說明** |
| Draft | 2015-1-26 | 台灣智慧型電網產業協會 |  | 版本制立 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**前 言**

為解決不同廠商AMI產品佈建互相聯結之問題，本會將參照國際標準組織制定標準流程，邀集AMI相關廠商或法人參與，訂定我國AMI互通性產業標準；本文件之目的係說明廠商或法人如何提出AMI互通性產業標準之建議提案，各提案廠商或法人需依本文件之規定提出相關之說明文件，後續再依本會提出之產業標準制定流程，訂定出我國AMI互通性之產業標準。

**目 錄**

[1. 建議提案之文件內容 1](#_Toc410052426)

[2. 通訊晶片生產廠商PHY&MAC互通性證書 1](#_Toc410052427)

[3. 通訊技術基本資料表 1](#_Toc410052428)

[4. 網路層通訊規範 2](#_Toc410052429)

[5. 網路層互通性測試規範 (含測試案例與測試步驟) 3](#_Toc410052430)

[6. 其他可供參考之說明文件 3](#_Toc410052431)

**建議提案之文件內容**

欲提案之廠商或法人，須依以下內容提供提案文件：

1. 提供通訊晶片生產廠商PHY&MAC互通性證書。
2. 填列通訊技術基本資料表 (內容詳本文件第2頁)
3. 網路層通訊規範
4. 網路層互通性測試規範 (含測試案例與測試步驟)
5. 其他可供參考之說明文件

以上各個項目，將於下面章節予以說明。

**通訊晶片生產廠商PHY&MAC互通性證書**

提案廠商或法人須針對建議的通訊晶片提供實體層 (Physical Layer) 與媒體存取控制層 (MAC Layer) 之互通性測試通過之文件。

**通訊技術基本資料表**

提案廠商或法人須依其建議提案填列下表，說明建議提案之網路層 (Network Layer) 相關資訊，內容須完整填列：

|  |
| --- |
| 通訊技術基本資料表 |
| 通訊方式：□有線通訊 □無線通訊 |
| 依循之國際標準說明﹝標準編號、發表年份、標準組織名稱等﹞： |
| 重要技術規格描述 (勾選有線通訊者填入) |
| 1. □窄頻，名稱： □寬頻，名稱： 2. 使用頻段說明： 3. 通訊規範涵蓋範圍： 4. 測試項目涵蓋範圍： 5. 其他 |
| 重要技術規格描述 (勾選無線通訊者填入) |
| 1. 實體層 (Physical Layer) 名稱： 2. 媒體存取控制層 (MAC Layer) 名稱： 3. 使用頻段說明： 4. 通訊規範涵蓋範圍： 5. 測試項目涵蓋範圍： 6. 其他 |

**網路層通訊規範**

提案廠商或法人須針對建議的通訊協定提出網路層通訊規範，如果係建議使用國際標準，需詳細載明標準的編號、發表年份、標準組織等足以識別明確標準之資訊，並提供中文敘述之通訊規範內容文件；如有標準規範以外之通訊協定，必須詳細說明通訊協定規範內容﹝網路層資料及指令格式等可供開發者開發參考之文件﹞。

**網路層互通性測試規範 (含測試案例與測試步驟)**

提案廠商或法人須針對建議的網路層通訊規範如何進行互通性驗證測試進行說明，至少應包含：

1. 測試項目
2. 測試案例與測試步驟：測試案例需涵蓋 A. 所有的測試項目

**其他可供參考之說明文件**

提案廠商或法人可提供其他文件，補充說明或佐證其建議提案內容。